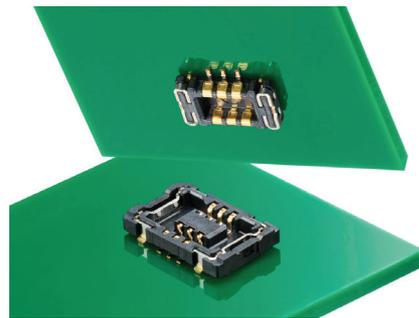


# SlimStack Board-to-Boardコネクタ 0.40mmピッチ HRFシリーズ

molex

0.40mmピッチ、嵌合高さ0.70mm、HRF (High Retention Force = 高保持力) シリーズのSlimStack B-to-Bコネクタは、強い振動や衝撃下においても、高い嵌合保持力で確実な接点接触を保証する製品です。このコネクタは、より高い接触信頼性が求められるモバイル機器向けに開発されており、落下や粗雑な取扱いにも強い構造となっています。

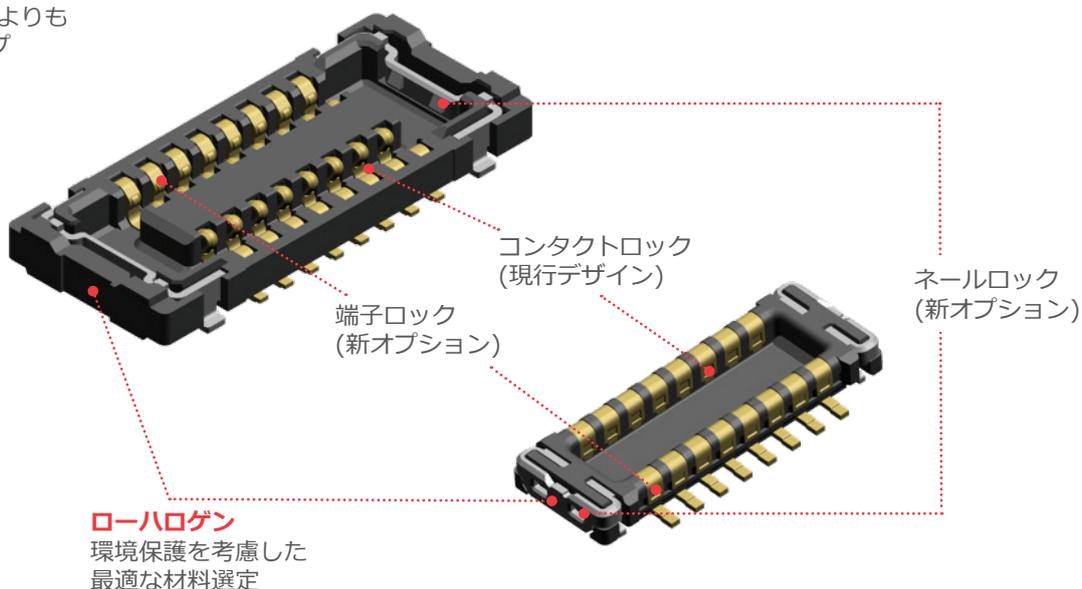
本製品は、2カ所のコンタクトフリクションロックとネール部のフリクションロックを用いることで、嵌合保持力をアップさせています。また、確実な電氣的接触を可能にするデュアルコンタクト構造、実装を容易にする幅広いハウジング吸着エリア、そして503304/503308シリーズと同一のフットパターンとすることで、コネクタ選択の自由度を上げています。



## 特徴・利点

### 高保持力

複数のロック機能を組み合わせることにより  
503304/503308シリーズよりも  
嵌合保持力を48%アップ



## アプリケーション

### モバイル機器

- スマートフォン
- タブレットPC
- ウェアラブル機器
- ポータブルオーディオ
- ポータブルナビゲーション機器



スマートフォン



ウェアラブル機器



ポータブルナビゲーション

# SlimStack Board-to-Boardコネクター 0.40mmピッチ HRFシリーズ

molex

## 仕様

### 参考情報

梱包形態: エンボステーピング  
寸法単位: mm  
RoHS: 準拠  
ハロゲンフリー: ローハロゲン

### 電気的性能

最大定格電圧: 50V  
最大定格電流: 0.3A (1極あたり)  
接触抵抗: 80 mΩ以下  
耐電圧: 250V AC  
絶縁抵抗: 100 MΩ以上

### 機械的性能

耐久挿抜回数: 最大30回

### 材質

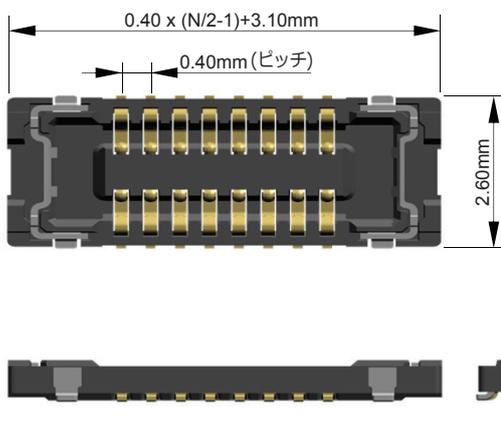
ハウジング: LCP、UL 94V-0、黒  
コンタクト: 銅合金  
メッキ:  
コンタクトエリア: 金  
半田付け部: 金  
下地メッキ: ニッケル  
使用温度範囲: -40 ~ +85°C

## 寸法

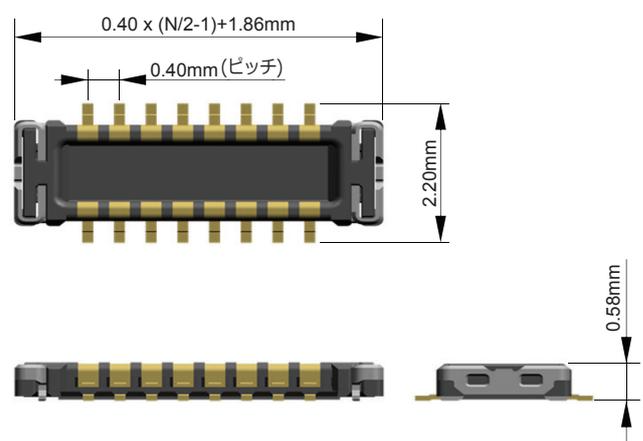
\* 詳細寸法は製品図面を参照してください。

N: 極数

### リセプタクル



### プラグ



## オーダーインフォメーション

オーダー番号		嵌合高さ (mm)	嵌合幅 (mm)	極数
リセプタクル	プラグ			
503548-**22	503552-**22	0.70	2.60	6, 10, 12, 14, 16, 18

\*\* : 極数

[www.molex.com/link/slimstack.html](http://www.molex.com/link/slimstack.html)  
[www.japanese.molex.com/link/slimstack.html](http://www.japanese.molex.com/link/slimstack.html)

Molexは、アメリカ合衆国におけるMolex, LLCの登録商標であり、他の国々でも登録されている場合があります。ここに表示されているその他すべての商標も該当する所有者に帰属します。